

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 3 部門第 3 区分  
 【発行日】平成 29 年 4 月 27 日 (2017.4.27)

【公表番号】特表 2016-535147 (P2016-535147A)  
 【公表日】平成 28 年 11 月 10 日 (2016.11.10)  
 【年通号数】公開・登録公報 2016-063  
 【出願番号】特願 2016-535318 (P2016-535318)  
 【国際特許分類】

C 0 8 L 81/02 (2006.01)  
 C 0 8 K 7/14 (2006.01)  
 C 0 8 L 101/12 (2006.01)  
 C 0 8 L 21/00 (2006.01)  
 B 2 9 C 45/14 (2006.01)

【 F I 】

C 0 8 L 81/02  
 C 0 8 K 7/14  
 C 0 8 L 101/12  
 C 0 8 L 21/00  
 B 2 9 C 45/14

【手続補正書】  
 【提出日】平成 29 年 3 月 17 日 (2017.3.17)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

( A ) ポリフェニレンサルファイド樹脂、及び ( B ) 異形断面ガラス繊維を含み、塩素含有量が 1 0 0 0 p p m 以下であるポリフェニレンサルファイド樹脂組成物であって、ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物の再結晶化温度は、2 2 0 未満であることを特徴とするポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 2】

ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物の再結晶化温度は、2 1 5 未満であることを特徴とする請求項 1 に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 3】

1 0 0 重量部の ( A ) ポリフェニレンサルファイド樹脂に対して、( B ) 異形断面ガラス繊維は 5 0 ~ 2 0 0 重量部であることを特徴とする請求項 1 に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 4】

更に、( C ) ガラス転移温度が 1 0 0 以上である非晶性樹脂を含むことを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれか 1 項に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 5】

1 0 0 重量部の ( A ) ポリフェニレンサルファイド樹脂に対して、( C ) ガラス転移温度が 1 0 0 以上である非晶性樹脂は、1 . 5 ~ 3 5 重量部であることを特徴とする請求項 4 に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 6】

( C ) ガラス転移温度が 1 0 0 以上である非晶性樹脂は、ポリカーボネート、ポリフ

エニルエーテル、非晶性ポリアリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド、ポリイミドまたは上記複数種のコポリマーのうちから選択される１種または複数種であることを特徴とする請求項４に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 ７】

(Ｃ) ガラス転移温度が 100 以上である非晶性樹脂は、ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物中に「島」状物を形成して分散し、それら「島」状物の平均面積は  $1\ \mu\text{m}^2$  / 個未満であることを特徴とする請求項４に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 ８】

(Ｂ) 異形断面ガラス繊維の扁平率は、1.5 以上であることを特徴とする請求項 1 ~ ３ のいずれか 1 項に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 ９】

315 下における剪断速度が  $1000\ \text{s}^{-1}$  のキャピラリーレオメーターの熔融粘度は、 $180\ \text{Pa} \cdot \text{s}$  未満であることを特徴とする請求項 1 ~ ３ のいずれか 1 項に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 10】

エラストマーを更に含有することを特徴とする請求項 1 ~ ３ のいずれか 1 項に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 11】

前記エラストマーは、オレフィン系エラストマー、変性オレフィン系エラストマー、またはスチレン系エラストマーのうちの１種または複数種であることを特徴とする請求項 10 に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物。

【請求項 12】

請求項 1 ~ 11 のいずれか 1 項に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物により製造される成形品。

【請求項 13】

成型品の厚みが、1.5 mm 以下であることを特徴とする請求項 12 に記載の成形品。

【請求項 14】

成型品の結晶度が、50 % 未満であることを特徴とする請求項 12 または 13 に記載の成形品。

【請求項 15】

請求項 12 ~ 14 のいずれか 1 項に記載の成形品により製造される携帯型パソコン、携帯電話、携帯型電子機器の筐体構成製品。

【請求項 16】

請求項 12 ~ 14 のいずれか 1 項に記載の成形品の製造方法であって、金型内インサート射出成形または金型内転写成形技術を採用し、裁断されたプラスチックフィルムを先ず金型内に配置し、その後、射出成形機により請求項 1 ~ 12 のいずれか 1 項に記載のポリフェニレンサルファイド樹脂組成物を射出成形し、成形金型の温度は前記 (Ａ) ポリフェニレンサルファイド樹脂のガラス転移温度以下であることを特徴とする成形品の製造方法。

【請求項 17】

成形金型の温度は、5 ~ 95 であることを特徴とする請求項 16 に記載の成形品の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物であって、前記ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物は（Ａ）ポリフェニレンサルファイド樹脂、及び（Ｂ）異形断面ガラス繊維を含み、前記ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物の塩素含有量は１０００ｐｐｍ以下であって、ポリフェニレンサルファイド樹脂組成物の再結晶化温度は、２２０未満であることを特徴とするポリフェニレンサルファイド樹脂組成物である。